

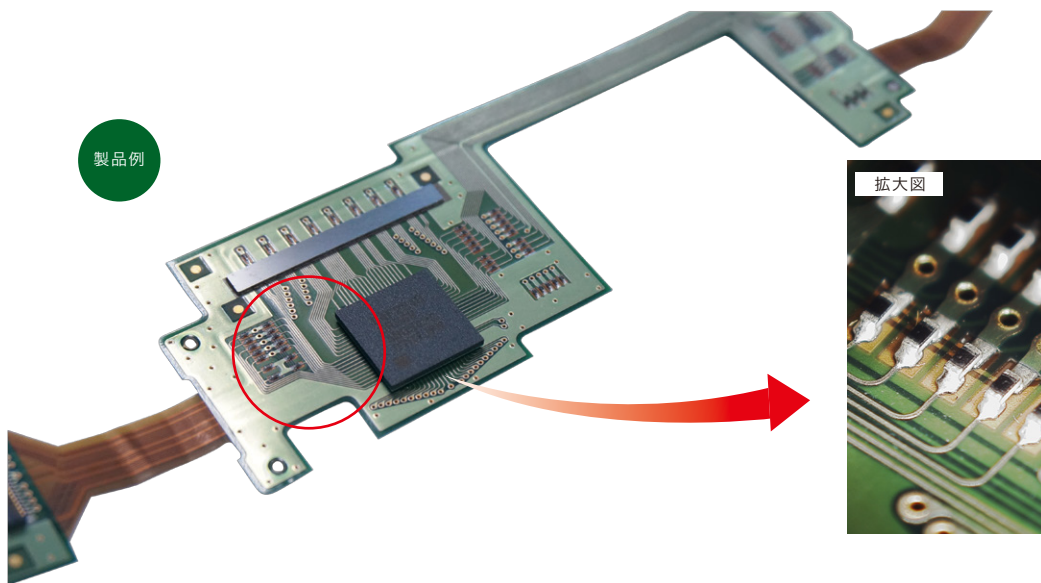
■ 部品実装

特長

- ・ 1日から対応可
- ・ ハロゲンフリーによる実装も対応可
- ・ X線検査対応可
- ・ BGAタイプの部品実装も対応可
- ・ 実装部品 調達可能（要相談）

短納期対応（中1日可）

両面実装に対応



■ ベアチップ実装FPC

特長

- ・ Auスタッドバンプ / ワイヤボンディング、フリップチップ実装、基板間接合対応
- ・ 最小ピッチ 38 μ m まで実績あり
- ・ ICチップはご支給となります

製品例

